

# 屹唐股份 (688729.SH)

## 新股覆盖研究

### 投资要点

- ◆ 下周二（6月24日）有一家科创板上市公司“屹唐股份”询价。
- ◆ **屹唐股份 (688729)**：公司主要从事集成电路制造过程中所需晶圆加工设备的研发、生产和销售，具体包括干法去胶设备、快速热处理设备、干法刻蚀设备等。公司2022-2024年分别实现营业收入47.63亿元/39.31亿元/46.33亿元，YOY依次为46.96%/-17.45%/17.84%；实现归母净利润3.83亿元/3.09亿元/5.41亿元，YOY依次为111.06%/-19.11%/74.78%。根据公司管理层初步预测，公司2025年1-6月营业收入较上年同期增长10.06%至19.63%，归母净利润较上年同期增长24.19%至37.09%。

① **投资亮点**：1、公司背靠北京国资、并通过跨国并购等方式，成为具备全球知名度的集成电路前道工艺设备制造商，在干法去胶、热处理、干法刻蚀等细分领域占据较高市场份额。据招股书显示，公司成立近10年，其实际控制人为北京经开区管委会下属的财政国资局、享有良好的政策支持和产业协同效应，于2016年收购美国知名半导体设备企业MTI；MTI成立于1988年、聚焦在价值量占比近八成的前道芯片制造工序，曾先后突破半导体领域干法去胶设备、快速热处理设备以及干法刻蚀设备。凭借此次收购整合，公司拥有了MTI较为完整知识产权及成熟产品线，并形成了以陆郝安先生为首的核心技术团队，其成员多数拥有在应用材料、英特尔、阿斯麦、泛林半导体、东京电子等集成电路领域头部企业从业20余年经验；此外，公司还在MTI原有的美国、德国两大研发制造基地的基础上建设了中国研发制造总部，进而构建全球化经营版图。经过多年发展，公司干法去胶设备及快速热处理设备已实现大规模装机，干法刻蚀设备已应用在多家国际知名集成电路制造商生产线上；截至2024年末、公司产品全球累计装机数量已超过4,800台，服务的客户全面覆盖全球前十大芯片制造商和国内行业领先芯片制造商。根据Gartner2023年统计数据，公司干法去胶设备、快速热处理设备分别凭借34.60%、13.05%的市场占有率位居全球第二，干法刻蚀设备市场占有率亦进入全球前十。2、公司积极致力于提供更先进处理能力和更高生产效率的集成电路前端专用设备，在持续推进成熟产品改进的同时，不断开展新产品开发。据招股书显示，一方面，公司持续推进Suprema®系列去胶设备、paradigmE®系列刻蚀设备、Helios®系列快速热退火设备以及Millios®系列毫秒退火设备等成熟产品的升级改造；另一方面，亦不断开展新产品开发。具体来看：1）去胶设备与刻蚀设备方面，报告期间公司推出了Hydrilis®高产能真空晶圆传输设备平台和基于该平台开发的Hydrilis®HMR高选择比先进光刻硬掩模材料去除设备、Novyka®系列高选择比刻蚀和原子层级表面处理设备等新产品，并成功实现量产销售；募投项目还将开发基于Hydrilis®真空晶圆传送平台技术的新一代超高产能去胶设备和刻蚀设备，预计新设备产能较成熟设备的产能提高一倍。2）热处理设备方面，先进尖峰退火、激光/闪光毫秒退火在内的快速热处理技术相比普通炉管退火设备几小时的加热时长，只需几秒甚至几毫秒便可使晶圆上升至所需温度，更好地提高晶圆的性能，满足先进集成电路制造的需求；公司正积极开展对新一代快速热退火尖峰退火设备、以及自由基快速热退火表面处理设备的研发，目前已处于在研阶段。

### 交易数据

总市值 (百万元)	
流通市值 (百万元)	
总股本 (百万股)	2,660.00
流通股本 (百万股)	
12个月价格区间	/

### 分析师

李蕙  
 SAC执业证书编号：S0910519100001  
 lihui1@huajinsec.cn

### 报告联系人

戴尊尊  
 daizhengzheng@huajinsec.cn

### 相关报告

- 华金证券-新股-新股专题覆盖报告（信通电子）-2025年44期-总第570期 2025.6.14
- 华金证券-新股-新股专题覆盖报告（新恒汇）-2025年43期-总第569期 2025.6.2
- 华金证券-新股-新股专题覆盖报告（交大铁发）-2025年第41期-总第567期 2025.6.2
- 华金证券-新股-新股专题覆盖报告（华之杰）-2025年42期-总第568期 2025.6.2
- 华金证券-新股-新股专题覆盖报告（海阳科技）-2025年第40期-总第566期 2025.5.25



① **同行业上市公司对比：**公司专注于晶圆加工设备领域；根据业务的相似性，选取中微公司、芯源微、华海清科、盛美上海、北方华创为屹唐股份的可比上市公司。从上述可比公司来看，2024 年度可比公司的平均收入规模为 99.36 亿元、平均 PE-TTM(剔除异常值/算数平均)为 36.70X、销售毛利率为 42.73%；相较而言，公司营收规模及销售毛利率未及同业平均。

◆ **风险提示：**已经开启询价流程的公司依旧存在因特殊原因无法上市的可能、公司内容主要基于招股书和其他公开资料内容、同行业上市公司选取存在不够准确的风险、内容数据截选可能存在解读偏差等。具体上市公司风险在正文内容中展示。

### 公司近 3 年收入和利润情况

会计年度	2022A	2023A	2024A
主营收入(百万元)	4,762.6	3,931.4	4,633.0
同比增长(%)	46.96	-17.45	17.84
营业利润(百万元)	400.0	264.4	520.9
同比增长(%)	89.80	-33.90	97.03
归母净利润(百万元)	382.5	309.4	540.8
同比增长(%)	111.06	-19.11	74.78
每股收益(元)	0.14	0.12	0.20

数据来源：聚源、华金证券研究所

## 内容目录

一、屹唐股份 .....	4
(一) 基本财务状况 .....	4
(二) 行业情况 .....	5
(三) 公司亮点 .....	7
(四) 募投项目投入 .....	8
(五) 同行业上市公司指标对比 .....	9
(六) 风险提示 .....	9

## 图表目录

图 1: 公司收入规模及增速变化 .....	4
图 2: 公司归母净利润及增速变化 .....	4
图 3: 公司销售毛利率及净利润率变化 .....	5
图 4: 公司 ROE 变化 .....	5
图 5: 全球集成电路制造干法去胶设备市场规模 (亿美元) .....	6
图 6: 全球热处理设备市场规模 (亿美元) .....	6
图 7: 全球集成电路制造刻蚀设备市场规模 (亿美元) .....	7
表 1: 公司 IPO 募投项目概况 .....	8
表 2: 同行业上市公司指标对比 .....	9

## 一、屹唐股份

公司是一家以中国、美国、德国三地作为研发、制造基地，面向全球经营的半导体设备企业，主要从事集成电路制造过程中所需晶圆加工设备的研发、生产和销售，具体提供包括干法去胶设备、快速热处理设备、干法刻蚀设备在内的集成电路制造设备及配套工艺解决方案。

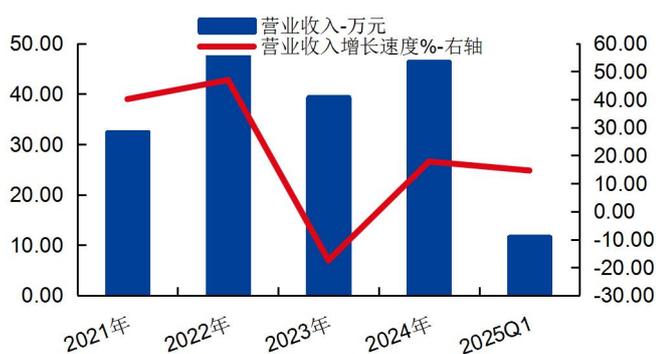
作为具备全球知名度和认可度的重要供应商，公司产品已被多家全球领先的存储芯片制造商、逻辑电路制造厂商等集成电路制造厂商所采用，服务的客户全面覆盖了全球前十大芯片制造商和国内行业领先芯片制造商；截至 2024 年末，公司产品全球累计装机数量已超过 4,800 台并在相应细分领域处于全球领先地位。

### （一）基本财务状况

公司 2022-2024 年分别实现营业收入 47.63 亿元/39.31 亿元/46.33 亿元，YOY 依次为 46.96%/-17.45%/17.84%；实现归母净利润 3.83 亿元/3.09 亿元/5.41 亿元，YOY 依次为 111.06%/-19.11%/74.78%。根据最新财务情况，公司 2025Q1 实现营业收入 11.60 亿元，较上年同期增长 14.63%；实现归母净利润 2.18 亿元，较上年同期增长 113.09%。

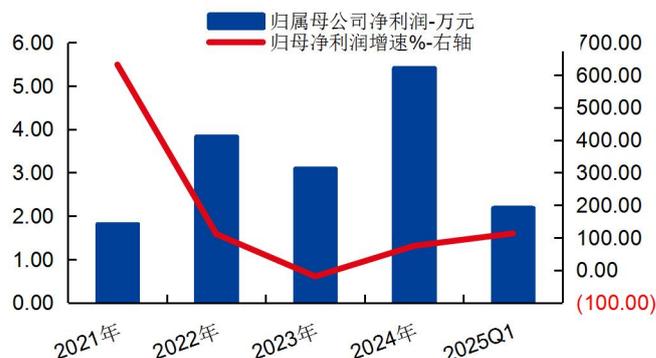
2024 年，公司主营收入按产品类别可分为四大板块，分别为专用设备 (35.59 亿元，76.82%)、备品备件 (9.70 亿元，20.93%)、服务 (0.99 亿元，2.13%)、特许权使用费 (0.05 亿元，0.12%)。2022 年至 2024 年间，专用设备始终为公司的核心产品及首要收入来源，收入占比稳定 65%以上，整体收入结构较为稳定。

图 1：公司收入规模及增速变化



资料来源：wind，华金证券研究所

图 2：公司归母净利润及增速变化



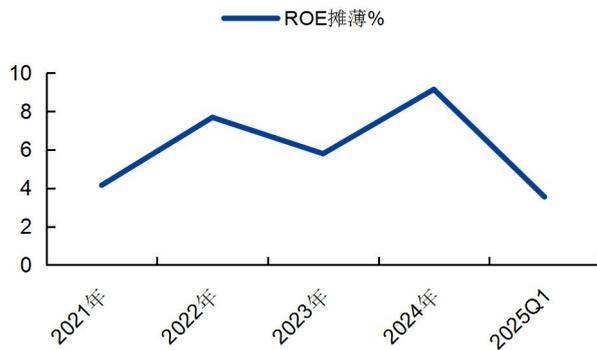
资料来源：wind，华金证券研究所

图 3：公司销售毛利率及净利润率变化



资料来源：wind，华金证券研究所

图 4：公司 ROE 变化



资料来源：wind，华金证券研究所

## （二）行业情况

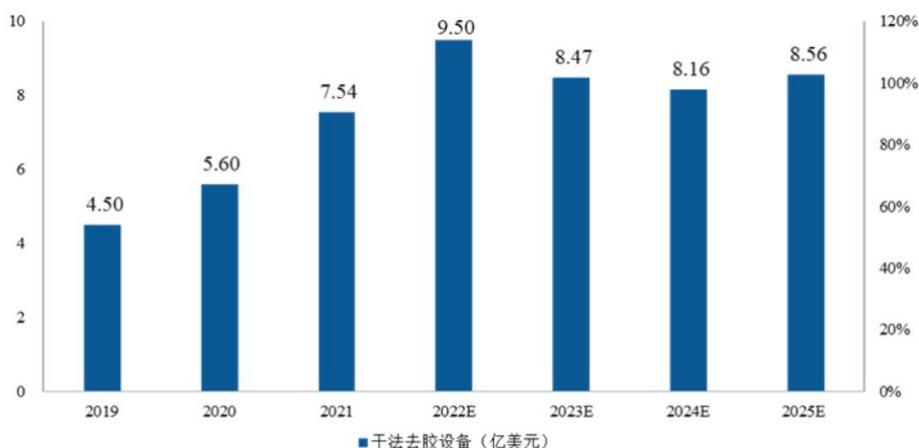
在集成电路制造设备行业中，公司主要产品属于去胶设备、快速热处理设备、刻蚀设备三个主要细分行业。

### 1、去胶设备市场

在光刻工艺中，晶圆表面被均匀覆盖光刻胶薄层后在光刻机中进行曝光；在光刻机曝光下改变了化学性质的光刻胶在显影步骤中被清除，光刻图形相应完成至光刻胶层的转移。随后，光刻胶层上的图形进一步通过刻蚀、离子注入等工艺被转移到晶圆表面；在刻蚀/离子注入等图形化工艺完成后，晶圆表面剩余光刻胶已完成图形转移和保护层的功能，通过去胶工艺进行完全清除，避免影响后续集成电路芯片制造工艺效果。

去胶工艺可分为湿法和干法两类，湿法去胶工艺使用溶剂对光刻胶等进行溶解；干法去胶工艺可视为等离子刻蚀技术的延伸，主要通过等离子体和薄膜材料的化学反应完成，是目前的主流工艺。在最先进的芯片制造工艺中，对底层材料的保护要求已达到原子级；干法去胶设备技术要求不断提高，干法去胶逐渐成为先进光刻中的一道关键步骤，设备应用也不断扩大。根据 Gartner 统计数据，2021 年全球集成电路制造干法去胶设备市场规模为 7.54 亿美元，预计 2022 年将达到 9.50 亿美元。

图 5：全球集成电路制造干法去胶设备市场规模（亿美元）



资料来源：Gartner、华金证券研究所

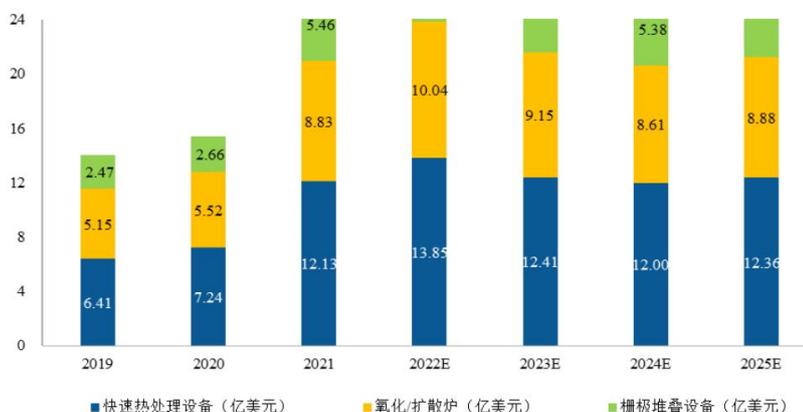
## 2、快速热处理设备市场

热退火 (Anneal) 是一种在集成电路制造过程中广泛应用的热处理技术，适用工艺包括和离子注入工艺结合使用以实现晶圆掺杂、金属薄膜沉积后金属硅化物烧结、晶圆表面改性（氧化、氮化）等。

近年来，先进尖峰退火、激光/闪光毫秒退火在内的快速热处理技术越来越受到集成电路制造厂商的关注。随着集成电路性能不断提高的要求，快速热退火技术在晶圆加工/集成电路制造中的竞争优势越来越明显：相比普通炉管退火设备几小时的加热时长，快速热退火设备只需几秒甚至几毫秒便可使晶圆上升至所需温度，总体热预算较低，可以更好地提高晶圆的性能，满足先进集成电路制造的需求。

根据 Gartner 统计数据，2021 年全球热处理设备市场规模合计 26.42 亿美元，其中快速热处理设备市场规模为 12.13 亿美元，氧化/扩散设备市场规模约 8.83 亿美元，栅极堆叠 (GateStack) 设备市场规模为 5.46 亿美元。2022 年快速热处理设备市场规模有望达到 13.85 亿美元。

图 6：全球热处理设备市场规模（亿美元）



资料来源：Gartner、华金证券研究所

## 3、刻蚀设备市场

刻蚀是指通过溶液、离子等方式剥离移除如硅、金属材料、介质材料等晶圆表面材料，从而达到集成电路芯片结构设计要求的一种工艺流程。从工艺技术来看，刻蚀可分为湿法刻蚀（WetEtching）和干法刻蚀（DryEtching）两类。80年代之后，随着集成电路工艺制程的逐渐升级以及芯片结构尺寸的不断缩进，湿法刻蚀在线宽控制、刻蚀方向性方面的局限性逐渐显现，并逐渐被干法刻蚀取代，目前仅用于特殊材料层的去除和残留物的清洗。

随着集成电路行业的不断发展，集成电路制造产业对于刻蚀工艺的复杂度要求不断上升，刻蚀技术也在不断地演进：主要运用设备已从只能进行有限控制的圆筒式刻蚀机，发展至集成刻蚀参数控制软件的现代等离子体刻蚀机。根据 Gartner 统计数据，2021 年，全球集成电路制造干法刻蚀设备市场规模增长至 199.24 亿美元，同比增长 45.63%，在全球集成电路制造设备市场的规模占比达 21.58%；2022 年，全球集成电路制造干法刻蚀设备市场规模预计将增长至 240.98 亿美元，增长率约为 20.95%。

图 7：全球集成电路制造刻蚀设备市场规模（亿美元）



资料来源：Gartner、华金证券研究所

备注：导体刻蚀包括硅刻蚀（SiliconEtch）及金属刻蚀（MetalEtch）等

### （三）公司亮点

1、公司背靠北京国资、并通过跨国并购等方式，成为具备全球知名度的集成电路前道工艺设备制造商，在干法去胶、热处理、干法刻蚀等细分领域占据较高市场份额。据招股书显示，公司成立近 10 年，其实际控制人为北京经开区管委会下属的财政国资局、享有良好的政策支持和产业协同效应，于 2016 年收购美国知名半导体设备企业 MTI；MTI 成立于 1988 年、聚焦在价值量占比近八成的前道芯片制造工序，曾先后突破半导体领域干法去胶设备、快速热处理设备以及干法刻蚀设备。凭借此次收购整合，公司拥有了 MTI 较为完整知识产权及成熟产品线，并形成了以陆郝安先生为首的核心技术团队，其成员多数拥有在应用材料、英特尔、阿斯麦、泛林半导体、东京电子等集成电路领域头部企业从业 20 余年经验；此外，公司还在 MTI 原有的美国、德国两大研发制造基地的基础上建设了中国研发制造总部，进而构建全球化经营版图。经过多年发展，公司干法去胶设备及快速热处理设备已实现大规模装机，干法刻蚀设备已应用在多家国际知名集成电路制造商生产线上；截至 2024 年末、公司产品全球累计装机数量已超过 4,800 台，服务的客户全面覆盖全球前十大芯片制造商和国内行业领先芯片制造商。根据 Gartner2023 年统

计数据，公司干法去胶设备、快速热处理设备分别凭借 34.60%、13.05% 的市场占有率位居全球第二，干法刻蚀设备市场占有率亦进入全球前十。

**2、公司积极致力于提供更先进处理能力和更高生产效率的集成电路前端专用设备，在持续推进成熟产品改进的同时，不断开展新产品开发。**公司积极提升研发制造产业化能力以夯实其国际领先的技术水平地位，2023 年至 2025Q1 公司研发费用率维持在 15% 以上。据招股书显示，一方面，公司持续推进 Suprema® 系列去胶设备、paradigmE® 系列刻蚀设备、Helios® 系列快速热退火设备以及 Millios® 系列毫秒退火设备等成熟产品的升级改造；另一方面，亦不断开展新产品开发。具体来看：1) 去胶设备与刻蚀设备方面，报告期间公司推出了 Hydrilis® 高产能真空晶圆传输设备平台和基于该平台开发的 Hydrilis®HMR 高选择比先进光刻硬掩模材料去除设备、Novyka® 系列高选择比刻蚀和原子层级表面处理设备等新产品，并成功实现量产销售；募投项目还将开发基于 Hydrilis® 真空晶圆传送平台技术的新一代超高产能去胶设备和刻蚀设备，预计新设备产能较成熟设备的产能提高一倍。2) 热处理设备方面，先进尖峰退火、激光/闪光毫秒退火在内的快速热处理技术相比普通炉管退火设备几小时的加热时长，只需几秒甚至几毫秒便可使晶圆上升至所需温度，更好地提高晶圆的性能，满足先进集成电路制造的需求；公司正积极开展对新一代快速热退火尖峰退火设备、以及自由基快速热退火表面处理设备的研发，目前已处于在研阶段。

#### (四) 募投资项目投入

公司本轮 IPO 募投资金拟投入 2 个项目，以及发展和科技储备资金。

- 1、屹唐半导体集成电路装备研发制造服务中心项目：**项目建成后，公司北京研发制造基地可实现干法去胶设备、快速热处理设备及干法刻蚀设备生产能力的大幅提升；并同步新增多个研发实验室、培训室，全面提升公司集成电路装备的研发、制造和服务能力。截至目前，该厂房主体结构建设、主要设备安装与调试已完工，并已于 2023 年投产。
- 2、屹唐半导体高端集成电路装备研发项目：**公司拟开展高端设备开展升级迭代和产品研发工作，增强公司技术水平，提升产品性能和产品质量。具体研发方向包括：原子层级表面处理及超高选择比刻蚀设备的技术改进和研发、先进干法去胶设备的技术研发、基于 Hydrilis® 平台的新一代超高产能去胶设备和刻蚀设备的技术改进和研发、高温真空快速退火及相关一体化半导体处理设备的技术研发、新型半导体刻蚀设备的技术研发、以及成熟集成电路设备持续改进与研发。

表 1：公司 IPO 募投资项目概况

序号	项目名称	项目投资总额 (亿元)	拟使用募集资金金额 (亿元)	项目建 设期
1	屹唐半导体集成电路装备研发制造服务中心项目	9.63	8.00	18 个月
2	屹唐半导体高端集成电路装备研发项目	10.00	10.00	-
3	发展和科技储备资金	7.00	7.00	-
	<b>总计</b>	<b>26.63</b>	<b>25.00</b>	<b>-</b>

资料来源：公司招股书，华金证券研究所

## （五）同行业上市公司指标对比

2024 年度，公司实现营业收入 46.33 亿元，同比增长 17.84%；实现归属于母公司净利润 5.41 亿元，同比增长 74.78%。根据管理层初步预测，公司预计 2025 年 1-6 月实现主营业务收入区间为 23 亿元至 25 亿元，较上年同期增长 10.06%至 19.63%；实现归母净利润区间为 3.08 亿元至 3.40 亿元，较上年同期增长 24.19%至 37.09%；实现扣非归母净利润区间为 2.21 亿元至 2.50 亿元，较上年同期增长 1.33%至 14.63%。

公司专注于晶圆加工设备领域；根据业务的相似性，选取中微公司、芯源微、华海清科、盛美上海、北方华创为屹唐股份的可比上市公司。从上述可比公司来看，2024 年度可比公司的平均收入规模为 99.36 亿元、平均 PE-TTM(剔除异常值/算数平均)为 36.70X、销售毛利率为 42.73%；相较而言，公司营收规模及销售毛利率未及同业平均。

表 2：同行业上市公司指标对比

代码	简称	总市值 (亿元)	PE-TTM	2024 年营业收入 (亿元)	2024 年营 收增速	2024 年归 母净利润 (亿元)	2024 年归 母净利润 增速	2024 年 销售毛利 率	2024 年 ROE (摊 薄)
688012.SH	中微公司	1,080.68	64.34	90.65	44.73%	16.16	-9.53%	41.06%	8.19%
688037.SH	芯源微	204.12	106.61	17.54	2.13%	2.03	-19.08%	37.67%	7.54%
688120.SH	华海清科	382.59	36.28	34.06	35.82%	10.23	41.40%	43.20%	15.81%
688082.SH	盛美上海	482.68	36.59	56.18	44.48%	11.53	26.65%	48.86%	15.04%
002371.SZ	北方华创	2,262.55	37.24	298.38	35.14%	56.21	44.17%	42.85%	18.09%
	平均值	882.53	36.70	99.36	32.46%	19.23	16.72%	42.73%	12.93%
<b>688729.SH</b>	<b>屹唐股份</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>46.33</b>	<b>17.84%</b>	<b>5.41</b>	<b>74.78%</b>	<b>37.39%</b>	<b>9.14%</b>

资料来源：Wind（数据截至日期：2025 年 6 月 19 日），华金证券研究所

备注：PE-TTM 计算剔除 PE 值异常的中微公司和芯源微。

## （六）风险提示

技术升级迭代的风险、与国际龙头在产品线覆盖广度存在较大差距的风险、市场竞争风险、客户集中度较高的风险、业绩波动的风险、贸易摩擦风险、对境外子公司的管控风险、公司规模扩张带来的管理和内控风险、商誉减值风险、存货跌价的风险等风险。

## 投资评级说明

公司投资评级：

买入—未来 6-12 个月内相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 15%；

增持—未来 6-12 个月内相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5%至 15%之间；

中性—未来 6-12 个月内相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%至 5%之间；

减持—未来 6-12 个月内相对同期相关证券市场代表性指数跌幅在 5%至 15%之间；

卖出—未来 6-12 个月内相对同期相关证券市场代表性指数跌幅大于 15%。

行业投资评级：

领先大市—未来 6-12 个月内相对同期相关证券市场代表性指数领先 10%以上；

同步大市—未来 6-12 个月内相对同期相关证券市场代表性指数涨跌幅介于-10%至 10%；

落后大市—未来 6-12 个月内相对同期相关证券市场代表性指数落后 10%以上。

基准指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准，美股市场以标普 500 指数为基准。

## 分析师声明

李蕙声明，本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，勤勉尽责、诚实守信。本人对本报告的内容和观点负责，保证信息来源合法合规、研究方法专业审慎、研究观点独立公正、分析结论具有合理依据，特此声明。

## 本公司具备证券投资咨询业务资格的说明

华金证券股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司及其投资咨询人员可以为证券投资人或客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或间接的有偿咨询服务。发布证券研究报告，是证券投资咨询业务的一种基本形式，本公司可以对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向本公司的客户发布。

## 免责声明：

本报告仅供华金证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因为任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但本公司不保证该等信息及资料的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映本公司于本报告发布当日的判断，本报告中的证券或投资标的价格、价值及投资带来的收入可能会波动。在不同时期，本公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，本公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。同时，本公司有权对本报告所含信息在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准。

在法律许可的情况下，本公司及所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务，提请客户充分注意。客户不应将本报告为作出其投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代客户自身的投资判断与决策。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，无论是否已经明示或暗示，本报告不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证。在任何情况下，本公司亦不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告版权仅为本公司所有，未经事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表、转发、篡改或引用本报告的任何部分。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华金证券股份有限公司研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

华金证券股份有限公司对本声明条款具有惟一修改权和最终解释权。

## 风险提示：

报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或询价。投资者对其投资行为负完全责任，我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

华金证券股份有限公司

办公地址：

上海市浦东新区杨高南路 759 号陆家嘴世纪金融广场 30 层

北京市朝阳区建国路 108 号横琴人寿大厦 17 层

深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 10 楼 05 单元

电话：021-20655588

网址：www.huajinsec.com